

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）上午 11:00-12:00；
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）；
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动；
- 投资者可于 2023 年 8 月 31 日（星期四）至 9 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jhtdesign@jht-design.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）召开时间：2023 年 9 月 7 日上午 11:00-12:00

(二) 召开地点：上证路演中心

(三) 召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。

四、投资者参加方式

1.投资者可在 2023 年 9 月 7 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于 2023 年 8 月 31 日（星期四）至 9 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jhtdesign@jht-design.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部；

联系电话：021-52277906；

联系传真：022-89129719；

联系邮箱：jhtdesign@jht-design.com。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日